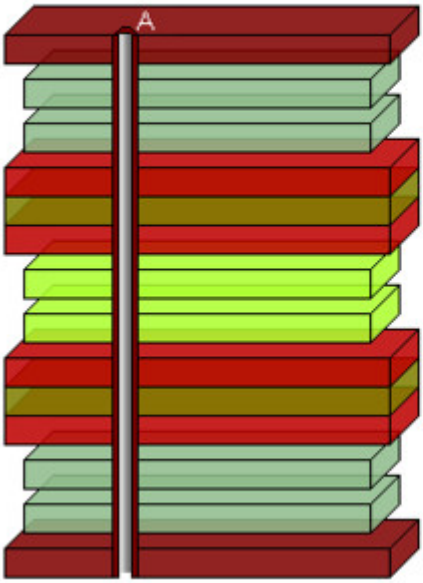
Multilayer 6 Lagen - 2,4 mm

Lagenaufbau



Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu		18+25	
	Prepreg	0.109		2116
	Prepreg	0.109		2116
	Cu		35	
2	Tr-Lam	0.71		
	Cu		35	
3	Prepreg	0.178		7628
	Prepreg	0.178		7628
	Cu		35	
4	Tr-Lam	0.71		
	Cu		35	
5	Prepreg	0.109		2116
	Prepreg	0.109		2116
6	Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke *	2,39	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske *	2,50	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Multilayer 6 Lagen - 2,4 mm

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 300 µm
	Viapad-Ø	≥ 600 µm
Leiterbild Außenlagen		
	Leiterbreite bei 9 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 9 µm Grundkupfer	≥ 80 µm ≥ 100 µm
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥100 µm ≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm ≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 190 µm ≥ 240 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm ≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥85 µm ≥ 100 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com